# 32 位 RISC CPU ARM 芯片的应用和选型

# 上海交通大学电机系(200030)周洁杨心怀

摘 要:ARM 公司以及 ARM 芯片的现状和发展,从应用的角度介绍了 ARM 芯片的选择方法,并介绍了具有多芯核结构的 ARM 芯片。列举了目前的主要 ARM 芯片供应商,其产品以及应用领域。举例说明了几种嵌入式产品的最佳 ARM 芯片选择方案。

关键词: ARM MMU SOC RISC CPU

ARM 公司自 1990 年正式成立以来,在 32 位 RISC (Reduced Instruction Set Computer) CPU 开发领域不断取得突破,其结构已经从 V3 发展到 V6。由于 ARM 公司自成立以来,一直以 IP( Intelligence Property )提供者的身份向各大半导体制造商出售知识产权,而自己从不介入芯片的生产销售,加上其设计的芯核具有功耗低、成本低等显著优点,因此获得众多的半导体厂家和整机厂商的大力支持,在 32 位嵌入式应用领域获得了巨大的成功,目前已经占有 75%以上的 32 位 RISC 嵌入式产品市场。在低功耗、低成本的嵌入式应用领域确立了市场领导地位。现在设计、生产 ARM 芯片的国际大公司已经超过 50 多家,国内中兴通讯和华为通讯等公司也已经购买 ARM 公司的芯核用于通讯专用芯片的设计。

目前非常流行的 ARM 芯核有 ARM7TDMI StrongARM, ARM720T ,ARM9TDMI ,ARM922T ,ARM940T ,RM946T , ARM966T ,ARM10TDMI 等。自 V5 以后 ,ARM 公司提供 Piccolo DSP 的芯核给芯片设计者 ,用于设计 ARM+DSP 的 SOC (System On Chip) 结构的芯片。此外 ,ARM 芯片还获得了许多实时操作系统(Real Time Operating System )供应商的支持 ,比较知名的有 :Windows CE、Linux、pSOS、VxWorks,Nucleus、EPOC、uCOS、BeOS 等。

随着国内嵌入式应用领域的发展 ,ARM 芯片必然会获得广泛的重视和应用。但是 ,由于 ARM 芯片有多达十几种的芯核结构 ,70 多家芯片生产厂家 ,以及千变万化的内部功能配置组合 ,给开发人员在选择方案时带来一定的困难。所以 ,对 ARM 芯片做一对比研究是十分必要的。

## 1 ARM 芯片选择的一般原则

从应用的角度,对在选择 ARM 芯片时所应考虑的主要因素做一详细的说明。

#### 1.1 ARM 芯核

如果希望使用 WinCE 或 Linux 等操作系统以减少软件开发时间,就需要选择 ARM720T 以上带有 MMU( memory management unit ) 功能的 ARM 芯片, ARM720T、StrongARM、ARM920T、ARM922T、ARM946T 都带有 MMU 功能。而 ARM7TDMI 没有 MMU,不支持 Windows CE 和大

部分的 Linux, 但目前有 uCLinux 等少数几种 Linux 不需要 MMU 的支持。

## 1.2 系统时钟控制器

系统时钟决定了 ARM 芯片的处理速度。ARM7 的处理速度为 0.9 MIPS/MHz,常见的 ARM7 芯片系统主时钟为 20 MHz-133 MHz, ARM9 的处理速度为 1.1 MIPS/MHz,常见的 ARM9 的系统主时钟为 100 MHz-233 MHz, ARM10 最高可以达到 700 MHz。不同芯片对时钟的处理不同,有的芯片只有一个主时钟频率,这样的芯片可能不能同时顾及 UART 和音频时钟的准确性,如 Cirrus Logic 的 EP7312 等;有的芯片内部时钟控制器可以分别为 CPU 核和 USB、UART、DSP、音频等功能部件提供不同频率的时钟,如 PHILIPS 公司的 SAA7750 等芯片。

## 1.3 内部存储器容量

在不需要大容量存储器时,可以考虑选用有内置存储器的 ARM 芯片。见表 1。

表 1 内置存储器的 ARM 芯片

芯片型号	供应商	FLASH 容量	ROM 容量	SRAM 容量
AT91F40162	ATMEL	2M Bytes		4K Bytes
AT91FR4081	ATMEL	1 M Bytes		128 K Bytes
SAA 7750	Philips	384K Bytes	256 K bytes	64 K bytes
PUC 3030 A	Micronas	256K Bytes		56 K bytes
HMS30C7202	Hynix	192K Bytes		
ML67Q4001	OKI	256K Bytes		
LC 67 F 500	Snayo	640 K Bytes		32 K bytes

#### 1.4 USB接口

许多 ARM 芯片内置有 USB 控制器,有些芯片甚至同时有 USB Host 和 USB Slave 控制器。见表 2。

## 1.5 GPIO 数量

在某些芯片供应商提供的说明书中,往往申明的是最大可能的 GPIO 数量,但是有许多引脚是和地址线、数据线、串口线等引脚复用的。这样在系统设计时需要计算实际可以使用的 GPIO 数量。

## 1.6 中断控制器

ARM 内核只提供快速中断(FIQ)和标准中断(IRQ)

6 欢迎邮购本刊 1995~1999 年光盘版 ,每套 100 元 《电子技术应用》2002 年第 8 期

表 2 内置 USB 控制器的 ARM 芯片

芯片型号	ARM 内核	供应商	USB Slave	USB Host	IIS 接口
S3C2410	ARM 920 T	Samsung	1	2	1
S3C2400	ARM 920 T	Samsung	1	2	1
S5N8946	ARM7TDMI	Samsung	1	0	0
L7205	ARM 720 T	Linkup	1	1	0
L7210	ARM 720 T	Linkup	1	1	0
EP9312	ARM 920 T	Cirrus Logic	0	3	1
Dragonball MX1	ARM 920 T	Motorola	1	0	1
SAA 7750	ARM 720 T	Philips	1	0	1
TMS320DSC2x	ARM7TDMI	TI	1	0	0
PUC 3030 A	ARM7TDMI	Micronas	1	0	5
AAEC-2000	ARM 920 T	Agilent	1	0	0
ML67100	ARM7TDMI	OKI	1	0	0
ML7051LA	ARM7TDMI	OKI	1	0	0
SA-1100	StrongARM	Intel	1	0	0
LH79531	ARM7TDMI	Sharp	1	0	0
GMS 320 C 7201	ARM720T	Hynix	1	0	1

两个中断向量。但各个半导体厂家在设计芯片时加入了自己不同的中断控制器,以便支持诸如串行口、外部中断、时钟中断等硬件中断。外部中断控制是选择芯片必须考虑的重要因素,合理的外部中断设计可以很大程度的减少任务调度的工作量。例如 PHILIPS 公司的SAA7750,所有 GPIO 都可以设置成 FIQ 或 IRQ,并且可以选择上升沿、下降沿、高电平、低电平四种中断方式。这使得红外线遥控接收、指轮盘和键盘等任务都可以作为背景程序运行。而 Cirrus Logic 公司的 EP7312 芯片,只有4个外部中断源,并且每个中断源都只能是低电平或者高电平中断,这样在用于接收红外线信号的场合时,就必须用查询方式,会浪费大量TMS3:

1.7 IIS(Integrate Interface of Sound)接口即集成音频接口。如果设计音频应用产品,IIS 总线接口是必需的。

#### 1.8 nWAIT 信号

外部总线速度控制信号。不是每个 ARM 芯片都提供这个信号引脚,利用这个信号与廉价的GAL 芯片就可以实现与符合 PCMCIA 标准的WLAN 卡和 Bluetooth 卡的接口,而不需要外加高成本的 PCMCIA 专用控制芯片。另外,当需要扩展外部 DSP 协处理器时,此信号也是必需的。

## 1.9 RTC (Real Time Clock)

很多 ARM 芯片都提供实时时钟功能,但方式不同。如 Cirrus Logic 公司的 EP7312 的 RTC 只是一个 32 位计数器,需要通过软件计算出年月日时分秒;而 SAA7750 和 S3C2410 等芯片的 RTC 直接提供年月日时分秒格式。

## 1.10 LCD 控制器

有些 ARM 芯片内置 LCD 控制器,有的甚至内置 64K 彩色 TFT LCD 控制器。在设计 PDA 和手持式显《电子技术应用》2002 年第8期

示记录设备时,选用内置 LCD 控制器的 ARM 芯片如 S1C2410 较为适宜。

#### 1.11 PWM 输出

有些 ARM 芯片有 2~8 路 PWM 输出,可以用于电机控制或语音输出等场合。

## 1.12 ADC 和 DAC

有些 ARM 芯片內置 2~8 通道 8~12 位通用 ADC,可以用于电池检测、触摸屏和温度监测等。PHILIPS 的 SAA7750 更是內置了一个 16 位立体声音频 ADC 和DAC,并且带耳机驱动。

#### 1.13 扩展总线

大部分 ARM 芯片具有外部 SDRAM 和 SRAM 扩展接口,不同的 ARM 芯片可以扩展的芯片数量即片选线数量不同,外部数据总线有8位、16位或32位。某些

特殊应用的 ARM 芯片如德国 Micronas 的 PUC 3030 A 没有外部扩展功能。

#### 1.14 UART 和 IrDA

几乎所有的 ARM 芯片都具有 1~2 个 UART 接口,可以用于和 PC 机通讯或用 Angel 进行调试。一般的 ARM 芯片通讯波特率为  $115,200\,\mathrm{bps}$  ,少数专为蓝牙技术应用设计的 ARM 芯片的 UART 通讯波特率可以达到  $920\,\mathrm{Kbps}$  ,如 Linkup 公司的 L7205。

## 1.15 DSP 协处理器 ,见表 3。

表 3 ARM+DSP 结构的 ARM 芯片

芯片型号	供应商	DSP core	DSP MIPS	应 用	
TMS320DSC2X	TI	16bits C5000	500	Digital Camera	
Dragonball MX1	Motorola	24bits 56000		CD-MP3	
SAA7750	Philips	24 bits EPIC	73	CD-MP3	
VWS 22100	Philips	16 bits OAK	52	GSM	
STLC 1502	ST	D950		VOIP	
GMS 30 C 3201	Hynix	16bits Piccolo		STB	
AT75 C 220	ATMEL	16bits OAK	40	IA	
AT75 C 310	ATMEL	16bits OAK	40 x 2	IA	
AT75 C 320	ATMEL	16bits OAK	60 X 2	IA	
L7205	Linkup	16bits Piccolo		Wireless	
L7210	Linkup	16bits Piccolo		Wireless	
Quatro	OAK	16bits OAK		Digital Image	

## 1.16 内置 FPGA

有些 ARM 芯片内置有 FPGA,适合于通讯等领域。 见表 4。

表 4 ARM+FPGA 结构的 ARM 芯片

芯片型号	供应商	ARM 芯核	FPGA 门数	引脚数
EPXA 1	Altera	ARM 922T	100 K	484
EPXA4	Altera	ARM 922 T	400 K	672
EPXA 10	Altera	ARM 922 T	1000 K	1020
TA7S20 系列	Triscend	ARM7TDMI	多种	多种

## 1.17 时钟计数器和看门狗

一般 ARM 芯片都具有 2~4 个 16 位或 32 位时钟计数器和一个看门狗计数器。

## 1.18 电源管理功能

ARM 芯片的耗电量与工作频率成正比,一般 ARM 芯片都有低功耗模式、睡眠模式和关闭模式。

#### 1.19 DMA 控制器

有些 ARM 芯片内部集成有 DMA (Direct Memory Access),可以和硬盘等外部设备高速交换数据,同时减少数据交换时对 CPU 资源的占用。

另外,还可以选择的内部功能部件有:HDLC, SDLC,CD-ROM Decoder,Ethernet MAC,VGA controller, DC-DC。可以选择的内置接口有:IIC ,SPDIF ,CAN ,SPI , PCI ,PCMCIA。 最后需说明的是封装问题。ARM 芯片现在主要的封装有 QFP、TQFP、PQFP、LQFP、BGA、LBGA 等形式 ,BGA 封装具有芯片面积小的特点,可以减少 PCB 板的面积,但是需要专用的焊接设备,无法手工焊接。另外一般BGA 封装的 ARM 芯片无法用双面板完成 PCB 布线,需要多层 PCB 板布线。

## 2 多芯核结构 ARM 芯片的选择

为了增强多任务处理能力、数学运算能力、多媒体以及网络处理能力,某些供应商提供的 ARM 芯片内置多个芯核,目前常见的有 ARM+DSP,ARM+FPGA,ARM+ARM 等结构。

## 2.1 多 ARM 芯核

为了增强多任务处理能力和多媒体处理能力,某些ARM 芯片内置多个ARM 芯核。例如 Portal player 公司

表 5 主要 ARM 芯片供应商及其代表性产品和主要应用领域

供应商	芯片 1	芯片 2	芯片 3	芯片 4	主要应用
Intel	SA-110	SA-1100	SA-1110	IXP1200	Palm PC, Network
TI	TMS 320 DSC 21	TMS320DSC24	TMS320DSC25	OMAP 1510	Digital Camera
Samsung	S3C44B0X	S3C2410	S3C4510	S5N8946	ADSL, PDA
Motorola	Dragonball MX1				BT, PDA
Philips	SAA 7750	VWS 22100	VCS 94250	VWS26001	MP3,GSM,3G,BT
Cirrus Logic	EP7209	EP7212	EP7312	EP9312	GP, MP3
Linkup	L7200	L7205	L7210		Wireless
ATMEL	AT91R40XXX	AT75C310	AT76C901	AT76C502	GP, Wireless
OKI	ML67100	ML7051LA	ML67Q4000	ML67Q2300	GP, BT
Sharp	LH75400/1	LH 79520	LH79531/2/3	LH7A400	Portable handheld
Qualcomm	MSP 1000	MSM 3000	MSM 5000	MSM 6000	CDMA
ST	STLC 1502	STw 2400			VOIP, BT
Infineon	PMB7754				BT
Analog	AD 20 MSP 430				GSM
Hynix	GMS30C7201	HMS 30 C 7202	HMS39C7092		STB, GP
Micronas	PUC 3030 A				GP, MP3
Conexant	CN 9414	CX 82100			Network, Modem
Agilent	AAEC-2000				IA
Portalplayer	PP5002				MP3, PDA
NEC	UPD 65977				Configurable
NetSilicon	NET+15	NET+40	NET+50		Ethernet
LSI Logic	CBP3.0	CBP4.0	L64324		CDMA
Alcatel	MTC20276	MTK 20141	MTK 20285	MTC 20277	ISDN, ADSL
Altera	EPXA 1	EPXA4	EPXA 10		Configurable
Panasonic	MN1A7T0200				PDA, Phone
Silicon Wave	SiW 1750				BT
OAK	Quatro				Digital Image
Rohm	BU 6611 AKU				ISDN
Parthus	InfoSream				Wireless Internet
Intersil	ISL3856				802.11b, WLAN
SiRF	SiRF Star II				GPS
Sirius	CDMAx	DIRAC			3G CDMA
Sanyo	VOL101				CD-R, HDC
Virata	Helium	Helium 200	Helium 210	Lithium	Communications
Agere	T8300	T8302			Mobile phone

注: GP:通用芯片;STB:机顶盒;IA:Internet 应用产品;BT:蓝牙;

HDC:硬盘控制器;Configurable:芯片集成有通用门阵列

的 PP5002 内部集成了两个ARM7TDMI 芯核,可以应用于便携式 MP3 播放器的编码器或解码器。从科胜讯公司(Conexant)分离出去的专门致力于高速通讯芯片设计生产的 MinSpeed 公司就在其多款高速通讯芯片中集成了 2~4 个 ARM7TDMI 内核。2.2 ARM 芯核+DSP 芯核

为了增强数学运算功能和多媒体处理功能,许多供应商在其ARM 芯片内增加了 DSP 协处理器。通常加入的 DSP 芯核有 ARM 公司的 Piccolo DSP 芯核、OAK 公司 16 位定点 DSP 芯核、TI 的

TMS320C5000 系列 DSP 芯核、Motorola 的 56K DSP 芯核等。见表 3。

## 2.3 ARM 芯核+FPGA

为了提高系统硬件的在线升级能力,某些公司在ARM 芯片内部集成了 FPGA。见表 4。

## 3 主要 ARM 芯片供应商

目前可以提供 ARM 芯片的著名欧美半导体公司 有:英特尔、德洲仪器、三星半导体、摩托罗拉、飞利浦 半导体、意法半导体、亿恒半导体、科胜讯、ADI公司、安 捷伦、高通公司、Atmel、Intersil、Alcatel、Altera、Cirrus Logic, Linkup, Parthus, LSI logic, Micronas, Wave、Virata、Portalplayer inc.、NetSilicon, Parthus。 见表 5。日本的许多著名半导体公司如东芝、三菱半导体、 爱普生、富士通半导体、松下半导体等公司较早期都 大力投入开发了自主的 32 位 CPU 结构,但现在都转 向购买 ARM 公司的芯核进行新产品设计。由于它们 购买 ARM 版权较晚,现在还没有可以销售的 ARM 芯 片,而OKI、NEC、AKM、OAK、Sharp、Sanyo、Sony、Rohm 等日本半导体公司目前都已经批量生产了 ARM 芯 片。韩国的现代半导体公司也生产提供 ARM 芯片。另 外,国外也有很多设备制造商采用 ARM 公司的芯核 设计自己的专用芯片,如美国的IBM、3COM和新加坡 的创新科技等。我国台湾地区可以提供 ARM 芯片的 公司有台积电、台联电、华帮电子等。其它已购买 ARM 芯核,正在设计自主版权专用芯片的大陆公司有华为 通讯和中兴通讯等。

#### 4 选择方案举例

表 6 列举的最佳方案仅供参考,由于 SOC 集成电路的发展非常迅速,今天的最佳方案到明天就可能不是最佳的了。因此任何时候在选择方案时,都应广泛搜寻一下主要的 ARM 芯片供应商,以找出最适合的芯片。

## 表 6 最佳应用方案推荐

第一选择方案	第二选择方案	注释
S3C2410	Dragon ball MX1	
SAA 7750		USB 和 CD-ROM 解码器
SAA 7750	PUC 3030 A	内置 USB 和 FLASH
L7205,L7210	Dragon ball MX1	高速串口和 PCMCIA 接口
STLC 1502		
TMS 320 DSC 24	TMS 320 DSC 21	内置高速图像处理 DSP
AT 75 C 320	AT75 C 310	内置双 DSP ,可以分别处理
		MODEM 和语音
VWS 22100	AD 20 MSP 430	专为 GSM 手机开发
S5N8946	MTK-20141	
GMS30C3201		VGA 控制器
MSM 6000	OMAP 1510	
MinSpeed 公司系列	JARM 芯片	多 ARM 核+多 DSP 核
	S3C2410 SAA7750 SAA7750 L7205,L7210 STLC 1502 TMS320DSC24 AT75C320 VWS22100 S5N8946 GMS30C3201 MSM 6000	S3C2410         Dragon ball MX1           SAA7750         PUC3030 A           L7205,L7210         Dragon ball MX1           STLC1502         TMS320DSC24           AT75 C320         AT75 C310           VWS22100         AD20 MSP 430           S5N8946         MTK - 20141           GMS30C3201

## 参考文献

1 Steve Furber. ARM System-on-chip Architecture, Addison-Wesley ,2000

(收稿日期:2002-03-02)



WWW.YMPOWER.COM

E-mail:ympower@ympower.com

开关电源专业设计生产厂

